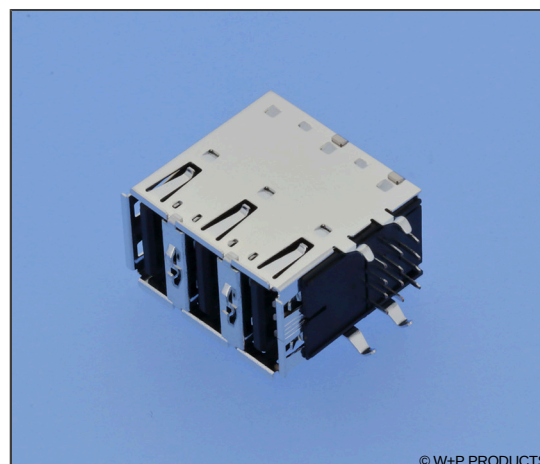
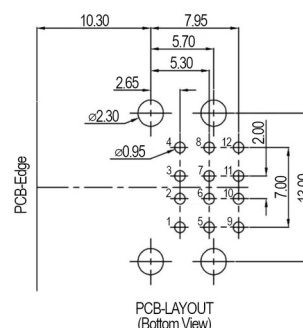
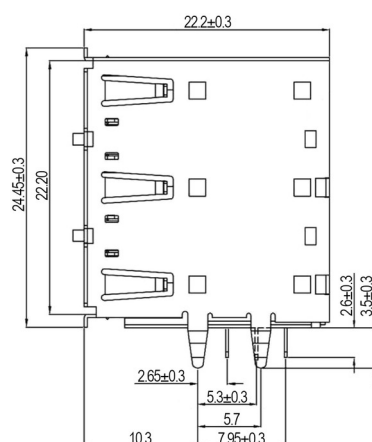
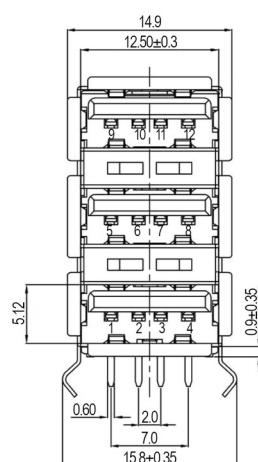


Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Messing, verzinkt
Shell	Rückwand : Stahl, vernickelt Tin plated brass
Isolierkörper	Rear shell: nickel plated steel
Insulator	Thermoplast, nach UL94 V-0
Kontaktmaterial	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Contact Material	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Copper alloy
Contact Surface	Gold über Nickel (siehe Optionen unten)
Oberfläche Lötanschluss	Gold over nickel (see options below)
Plating Solder Side	Zinn über Nickel
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	Tin plated over nickel
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	keine
Durchgangswiderstand	none
Contact Resistance	< 30 mΩ
Isolationswiderstand	< 30 mΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	> 1000 MΩ
Test Voltage	500 V AC
Nennspannung	500 V AC
Voltage Rating	30 V RMS
Nennstrom	30 V RMS
Current Rating	1,5 A bei 25°C
Temperaturbereich	1,5 A at 25°C
Temperature Range	-25 °C ... +85 °C
Verarbeitung	-25 °C ... +85 °C
Processing	Wellenlötverfahren
	Wave soldering



© W+P PRODUCTS



Series	Type	Model	Colour*	Plating*
833	1	5	10	80
	1 Type A (female)	5 Gewinkelt, 3-fach horizontal Right-angled, horizontal 3-port	10 Schwarz Black 30 Weiß White	60 Sel. Au/Sn 80 Sel. Au 0,75µm/Sn (USB 2.0)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

